第3章　価値創造への取り組み

事業別戦略

もともとはボールベアリング専門メーカーとして創業した当社は、機械加工で培った超精密加工技術をはじめとするコア技術を電子機器事業へ応用。

多角的な事業ポートフォリオが世界でも類をみない「相合(そうごう)精密部品メーカー」としてユニークなポジションを構築し、リスク分散にも寄与しています。

各事業セグメントでダイナミックに市場展開しており、それぞれ異なる事業機会、リスク、そしてそれらに向けた対応策があります。次ページ以降では、事業概況を含む事業戦略を説明します。

機械加工品事業

主要製品

主な製品
ボールベアリング、ロッドエンドベアリング、スフェリカルベアリング、ファスナー、ピボットアッセンブリー

主な用途

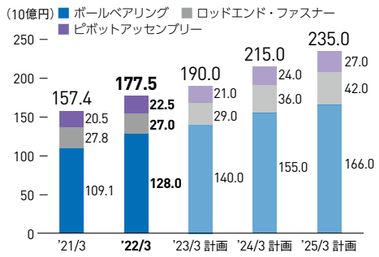
自動車、高級家電、HDD、データセンター、ドローン、医療機器、航空機、ロボット

ハイライト

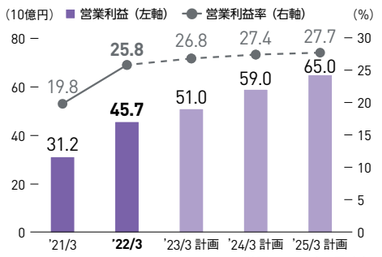
ボールベアリングは総販売数量および生産数量ともに過去最高を記録。
23/3期の大幅増産に向けた生産能力増強が着実に進行。

- 営業利益率 25%超
- 世界シェア No.1
- 生産能力 大幅増強中
- 航空機需要 回復中

売上高

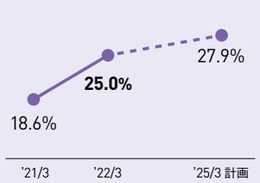


営業利益／営業利益率



※ '23/3～'25/3計画は2022年5月時点。

ROIC ハイライト



主にボールベアリングを中心とする利益率の回復により ROIC は上昇しました。

電子機器事業

主要製品

主な製品
HDD スピンドルモーター、ステッピングモーター、ファンモーター、DC モーター、LED バックライト、レゾナントデバイス、センシングデバイス

主な用途

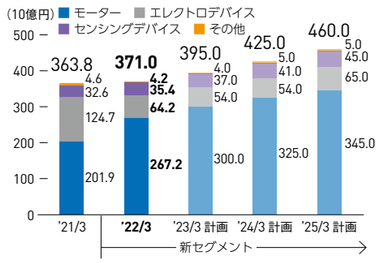
自動車、高級家電、HDD、ゲーム機器、OA 機器、医療機器、スマートフォン、ウェアラブル機器

ハイライト

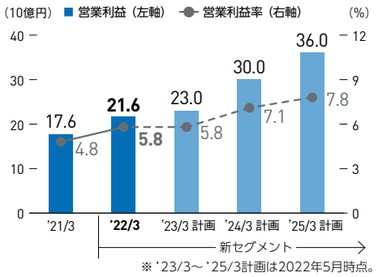
材料費高騰や半導体不足の影響を受けたものの、モーターを中心に前期比で大幅な増益を達成。

- モーター売上 32%増
- モーター事業 大幅増益
- 電装化による 事業機会拡大
- 製品ポートフォリオ 拡大中

売上高

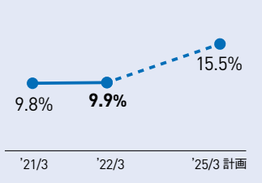


営業利益／営業利益率



※ '23/3～'25/3計画は2022年5月時点。

ROIC ハイライト



利益はモーターを中心に増益となりました。投下資本は車載製品向けを中心に原材料在庫が増加しました。

ミツミ事業

主要製品

主な製品
精密部品、光デバイス、電源、機構部品、スマート製品、住宅機器用部品、アナログ半導体

主な用途

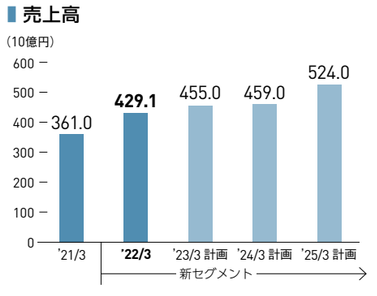
スマートフォン、高級家電、IoT 機器、ゲーム機器、データセンター、自動車、住宅機器、ウェアラブル機器、医療機器

ハイライト

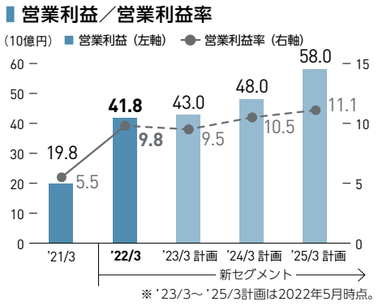
過去最高益を達成。アナログ半導体の大幅な利益拡大、光デバイスの需要増で確かな収益源として確立。

- ROIC 19%
- 営業利益 過去最高
- アナログ半導体 絶好調
- 光デバイス 大幅増収

売上高

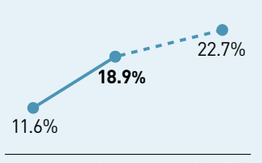


営業利益／営業利益率



※ '23/3～'25/3計画は2022年5月時点。

ROIC ハイライト



投下資本の増加を最小限にとどめつつ利益が倍増した結果、ROIC は大幅に上昇しました。

ユーシン事業

主要製品

主な製品
自動車部品（ドアラッチ、ドアハンドル等）、無線通信デバイス、産業機械部品

主な用途

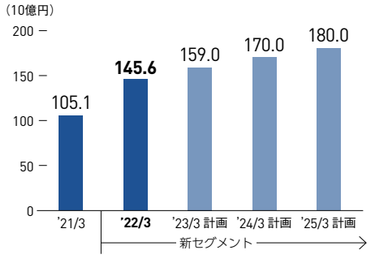
自動車、農業機械、建設機械

ハイライト

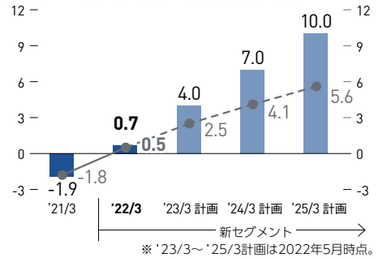
半導体不足による顧客の生産調整の影響を受けるも、第 4 四半期で黒字転換を達成。欧州構造改革は計画通りに完了。

- 営業利益 黒字化
- 欧州構造改革 完了
- 高機能化による 高付加価値化
- 新規ビジネス 獲得中

売上高

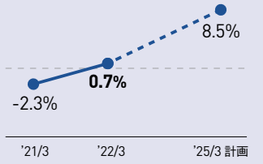


営業利益／営業利益率



※ '23/3～'25/3計画は2022年5月時点。

ROIC ハイライト



自動車向け製品の販売増加およびコスト構造の改善により黒字転換となりました。

※ 2022 年 3 月期より一部事業についてセグメントの移管を実施しております。